



平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成 22年 7月 28日

上場会社名 日立化成工業株式会社 上場取引所 東・大
 コード番号 4217 URL <http://www.hitachi-chem.co.jp>
 代表者 (役職名)執行役社長 (氏名) 田中 一行
 問合せ先責任者 (役職名)CSR統括部 コーポレートコミュニケーション
 センタ 副センタ長 (氏名) 加藤 丈士 TEL 03 - 5381 - 2370
 四半期報告書提出予定日 平成22年8月6日 配当支払開始予定日 -
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満四捨五入)

1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)

(1) 連結経営成績 (累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第1四半期	125,517	25.0	12,846	128.8	13,946	128.8	7,984	83.1
22年3月期第1四半期	100,411	△31.7	5,614	△59.0	6,094	△57.9	4,361	△49.7

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	
	円	銭	円	銭
23年3月期第1四半期	38	34	-	-
22年3月期第1四半期	20	94	-	-

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
23年3月期第1四半期	421,480		282,729		63.8		1,291.82	
22年3月期	426,586		282,602		62.9		1,289.11	

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 269,026 百万円 22年3月期 268,463 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年3月期	-	15.00	-	17.00	32.00
23年3月期	-	-	-	-	-
23年3月期(予想)	-	17.00	-	17.00	34.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 無

3. 平成23年3月期の連結業績予想 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
第2四半期(累計)	253,000	17.3	24,500	52.6	25,000	67.9	15,000	52.8	72.03	
通期	498,000	9.4	46,500	21.3	46,500	27.4	28,000	19.1	134.45	

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 : 有

4. その他（詳細は、【添付資料】P. 4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動：無

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更：有

② ①以外の変更：有

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	23年3月期1Q	208,364,913株	22年3月期	208,364,913株
② 期末自己株式数	23年3月期1Q	110,971株	22年3月期	109,761株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	23年3月期1Q	208,254,344株	22年3月期1Q	208,268,891株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及びその他関連する事項については、【添付資料】P. 3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	P. 3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	P. 3
2. その他の情報	P. 4
(1) 重要な子会社の異動の概要	P. 4
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	P. 4
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	P. 4
3. 四半期連結財務諸表	P. 5
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 5
(2) 四半期連結損益計算書	P. 7
(3) 継続企業の前提に関する注記	P. 8
(4) セグメント情報	P. 8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	P. 8
[補足資料]	P. 9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

2010年4月1日から同年6月30日までの連結業績につきましては、売上高は1,255億17百万円(前年同期比25.0%増)となりました。中国を中心としたデジタル家電等の堅調な需要に加え、自動車市場における需要の回復等により、機能材料セグメント、先端部品・システムセグメントとも売上高は前年同期実績を上回りました。その結果、営業利益は128億46百万円(前年同期比128.8%増)、経常利益は139億46百万円(前年同期比128.8%増)、四半期純利益は79億84百万円(前年同期比83.1%増)と前年同期実績を上回りました。

セグメント別の営業の状況は以下のとおりです(各セグメントの売上高は、セグメント間内部売上高消去後の数値を記載)。

機能材料セグメント

当セグメントの売上高は前年同期実績の13.7%増に当たる657億97百万円となりました。

① 電子材料

半導体用エポキシ封止材は、中国におけるデジタル家電等の需要増により前年同期実績を上回りました。

半導体用ダイボンディング材料は、競争激化の影響等により前年同期実績を下回りました。

半導体回路平坦化用研磨材料は、海外に比べて回復が遅れていた国内需要の回復を背景に前年同期実績を上回りました。

電気絶縁用ワニスは、液晶ディスプレイ回路の表面保護向けに売上が増加したほか、ハイブリッド自動車用途の拡大により、前年同期実績を上回りました。

② 無機材料

リチウムイオン電池用カーボン負極材は、携帯電話及びノートパソコン向けの需要拡大に伴い、前年同期実績を上回りました。

カーボン製品は、電刷子が自動車用に需要が回復したため、前年同期実績を上回りました。

セラミックスは、半導体製造装置向け及び自動車ウォーターポンプ向けの需要回復に伴い、前年同期実績を上回りました。

③ 樹脂材料

塗料用樹脂は、建材向けや自動車向けを中心に売上が伸長し、前年同期実績を上回りました。

粘着フィルムは、液晶ディスプレイの光学シート表面保護用等の需要拡大に加え、半導体製造プロセス用の採用拡大により、前年同期実績を上回りました。

ディスプレイ用回路接続フィルムは、中国における液晶テレビ等の需要増により、前年同期実績を上回りました。

④ 配線板材料

銅張積層板は、半導体パッケージ用基板向けを中心に売上が伸長し、前年同期実績を上回りました。

感光性フィルムは、中国の旺盛な需要を取り込み、前年同期実績を上回りました。

⑤ その他

非接触式ICカード・タグは、アミューズメント分野での採用拡大により、前年同期実績を上回る売上となりました。

先端部品・システムセグメント

当セグメントの売上高は前年同期実績の40.4%増に当たる597億20百万円となりました。

① 自動車部品

内・外装成形品、摩擦材、粉末冶金製品は、自動車市場の回復により、前年同期実績を上回る売上となりました。

②電子部品

配線板は、携帯電話向けの採用拡大に加え、半導体テスター関連の需要が回復傾向にあること等から前年同期実績を上回りました。

③その他

電池は、自動車生産の回復に伴い新車用の需要が増加したほか、フォークリフト向けが回復したことにより、前年同期実績を上回りました。

コンデンサは、風力・太陽光発電向けに売上を伸ばし、前年同期実績を上回りました。

診断薬・装置は、アレルギー診断薬を中心に売上を伸ばしたことにより、前年同期実績を上回りました。

(2)連結財政状態に関する定性的情報

①資産

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から51億6百万円減少し4,214億80百万円となりました。主に法人税等の支払により関係会社預け金が減少し、流動資産が32億50百万円減少したことによるものです。

②負債

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から52億33百万円減少し1,387億51百万円となりました。主に法人税等の支払により未払法人税等が減少し、流動負債が59億19百万円減少したことによるものです。

③純資産

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末から1億27百万円増加し2,827億29百万円となりました。評価・換算差額等が38億93百万円減少する一方、主に利益剰余金が増加し、株主資本が44億56百万円増加したことによるものです。

(3)連結業績予想に関する定性的情報

2011年3月期第2四半期(累計)の業績予想につきましては、当第1四半期において主に中国を中心とするデジタル家電等の需要に支えられたことから、売上が好調に推移し、前回発表の予想を上回る見込みです。この結果、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましても、予想を上回る見込みです。なお、通期の業績予想につきましては、景気回復が緩やかなものにとどまっております。依然先行きに不透明さが残ることから、下期の数値は期初の公表値を据え置いて修正してまいります。

〔第2四半期(累計)〕

	今回予想(A)	当初予想(B)	増減額(A-B)	増減率
売上高	2,530億円	2,400億円	130億円	5.4%
営業利益	245億円	200億円	45億円	22.5%
経常利益	250億円	195億円	55億円	28.2%
当期純利益	150億円	125億円	25億円	20.0%

〔通期〕

	今回予想(A)	当初予想(B)	増減額(A-B)	増減率
売上高	4,980億円	4,850億円	130億円	2.7%
営業利益	465億円	420億円	45億円	10.7%
経常利益	465億円	410億円	55億円	13.4%
当期純利益	280億円	255億円	25億円	9.8%

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当なし

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(簡便な会計処理)

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。なお、法人税等調整額は法人税等を含めて表示しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これにより、特別損失として620百万円を計上しております。

② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年3月10日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる影響額は軽微であります。

③ 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であるHitachi Chemical (Thailand) Co., Ltd. (旧商号: Siam HPM Co., Ltd.) 他1社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について、連結上必要な調整を行っていましたが、より適切な経営情報を把握するために、当第1四半期連結会計期間より、連結決算日における仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更しております。なお、各社の2010年1月1日から同年3月31日までの損益については、利益剰余金に直接計上しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (2010年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (2010年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	34,282	33,434
受取手形及び売掛金	106,792	105,059
製品	19,755	16,504
仕掛品	10,490	9,306
原材料	10,805	10,727
関係会社預け金	54,457	64,169
その他	22,243	22,220
貸倒引当金	△5,389	△4,734
流動資産合計	253,435	256,685
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	42,093	42,669
機械装置及び運搬具（純額）	49,762	51,394
土地	19,188	19,220
その他（純額）	13,838	13,361
有形固定資産合計	124,881	126,644
無形固定資産	5,362	5,737
投資その他の資産		
投資有価証券	20,446	20,114
その他	18,220	18,329
貸倒引当金	△864	△923
投資その他の資産合計	37,802	37,520
固定資産合計	168,045	169,901
資産合計	421,480	426,586

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (2010年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (2010年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	57,702	54,586
短期借入金	11,109	11,763
未払法人税等	4,426	11,308
その他	33,166	34,665
流動負債合計	106,403	112,322
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	3,156	2,492
退職給付引当金	15,430	15,552
役員退職慰労引当金	1,251	1,456
負ののれん	483	645
その他	2,028	1,517
固定負債合計	32,348	31,662
負債合計	138,751	143,984
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,454	15,454
資本剰余金	36,113	36,113
利益剰余金	232,212	227,754
自己株式	△183	△181
株主資本合計	283,596	279,140
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,326	1,985
繰延ヘッジ損益	△65	△20
為替換算調整勘定	△15,831	△12,642
評価・換算差額等合計	△14,570	△10,677
少数株主持分	13,703	14,139
純資産合計	282,729	282,602
負債純資産合計	421,480	426,586

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2009年4月1日 至 2009年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2010年4月1日 至 2010年6月30日)
売上高	100,411	125,517
売上原価	76,720	92,344
売上総利益	23,691	33,173
販売費及び一般管理費		
退職給付引当金繰入額	528	361
貸倒引当金繰入額	765	507
従業員給料及び手当	4,924	5,598
荷造及び発送費	3,182	3,848
研究開発費	3,566	3,891
その他	5,112	6,122
販売費及び一般管理費合計	18,077	20,327
営業利益	5,614	12,846
営業外収益		
受取利息	57	59
受取配当金	102	136
受取ロイヤリティー	427	608
負ののれん償却額	353	162
持分法による投資利益	—	494
その他	975	770
営業外収益合計	1,914	2,229
営業外費用		
支払利息	227	144
固定資産処分損	64	128
為替差損	103	285
持分法による投資損失	141	—
製品補修費	349	—
その他	550	572
営業外費用合計	1,434	1,129
経常利益	6,094	13,946
特別利益	—	—
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	620
特別損失合計	—	620
税金等調整前四半期純利益	6,094	13,326
法人税等	1,748	4,907
少数株主損益調整前四半期純利益	—	8,419
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△15	435
四半期純利益	4,361	7,984

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(4) セグメント情報

当第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

また、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、当第1四半期から適用する新セグメント区分に組み替えて表示しております。

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、材料から部材、さらに部品へと、製品の加工度に応じた括りによる組織体制に基づき、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、製品の加工度別に、材料を「機能材料」、部材及び部品を「先端部品・システム」の各セグメントに分類し、これら2つを報告セグメントとしております。

「機能材料」事業では、電子材料、無機材料、樹脂材料、配線板材料等の製造・販売を行っており、「先端部品・システム」事業では、自動車部品、電子部品等の製造・販売を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第1四半期連結累計期間(自2009年4月1日至2009年6月30日)

(単位:百万円)

科 目	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	機能材料	先端部品・ システム	計		
売 上 高					
(1) 外部顧客への 売 上 高	57,885	42,526	100,411	—	100,411
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	967	137	1,104	(1,104)	—
計	58,852	42,663	101,515	(1,104)	100,411
セグメント利益又は損失	7,524	(1,817)	5,707	(93)	5,614

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去額であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自2010年4月1日至2010年6月30日)

(単位:百万円)

科 目	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	機能材料	先端部品・ システム	計		
売 上 高					
(1) 外部顧客への 売 上 高	65,797	59,720	125,517	—	125,517
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,957	125	2,082	(2,082)	—
計	67,754	59,845	127,599	(2,082)	125,517
セグメント利益	9,626	3,223	12,849	(3)	12,846

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし

〔補足資料〕

1. 前連結会計年度のセグメント情報

前連結会計年度のセグメント情報につきまして、当第1四半期から適用する新セグメント区分に組み替えた場合、四半期連結会計期間ごとの売上高及び営業損益の金額は以下のとおりです。

(単位：百万円)

	2010年3月期				
	第1四半期 (自 2009年4月1日 至 2009年6月30日)	第2四半期 (自 2009年7月1日 至 2009年9月30日)	第3四半期 (自 2009年10月1日 至 2009年12月31日)	第4四半期 (自 2010年1月1日 至 2010年3月31日)	年度計 (自 2009年4月1日 至 2010年3月31日)
売上高	100,411	115,320	120,096	119,460	455,287
機能材料	57,885	62,206	61,996	58,617	240,704
先端部品・システム	42,526	53,114	58,100	60,843	214,583
営業損益	5,614	10,446	11,953	10,328	38,341
機能材料	7,524	8,274	8,812	7,573	32,183
先端部品・システム	△ 1,817	2,161	3,144	2,748	6,236
調整額	△ 93	11	△ 3	7	△ 78

2. 各セグメントの主要製品

セグメント	主要製品
機能材料	電子材料 半導体用エポキシ封止材、半導体用ダイボンディング材料、半導体回路平坦化用研磨材料、電気絶縁用ワニス 無機材料 リチウムイオン電池用カーボン負極材、カーボン製品、セラミックス 樹脂材料 塗料用樹脂、粘着フィルム、ディスプレイ用回路接続フィルム、接着剤 配線板材料 銅張積層板、感光性フィルム その他 非接触式ICカード・タグ
先端部品・システム	自動車部品 内・外装成形品、摩擦材、粉末冶金製品 電子部品 配線板 その他 電池、コンデンサ、診断薬・装置